

## Circuit board recess formation method for telecommunication terminal

**Publication number:** DE19706281

**Publication date:** 1998-08-20

**Inventor:** HOLDSCHLAG WERNER DIPL ING (DE); UMLAND  
CLAUDE DIPL ING (DE)

**Applicant:** SIEMENS AG (DE)

**Classification:**

**- international:** *H05K1/11; H05K3/30; H05K3/32; H05K3/42; H05K1/11;  
H05K3/30; H05K3/32; H05K3/42; (IPC1-7): H05K3/42*

**- european:** H05K1/11G; H05K3/30D2; H05K3/32C2

**Application number:** DE19971006281 19970218

**Priority number(s):** DE19971006281 19970218

**Report a data error here**

### Abstract of DE19706281

The recess (5) for insertion of an end (9) of a wire (6) is formed by the drilling of two smaller holes (7,8) of corresponding diameter in the board (13). Midway between these a third hole (10) is made with a diameter extending to the centre of each of the first two holes. To secure a wire, the end of the wire is bent into a U-shape with two right-angle bends between its limbs (11,12) to limit the depth of its insertion. The wire is held securely in the semi-cylindrical small holes, and makes good electrical contact.

---

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



①⑨ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 197 06 281 A 1**

⑤① Int. Cl.<sup>6</sup>:  
**H 05 K 3/42**

②① Aktenzeichen: 197 06 281.4  
②② Anmeldetag: 18. 2. 97  
④③ Offenlegungstag: 20. 8. 98

DE 197 06 281 A 1

⑦① Anmelder:  
Siemens AG, 80333 München, DE

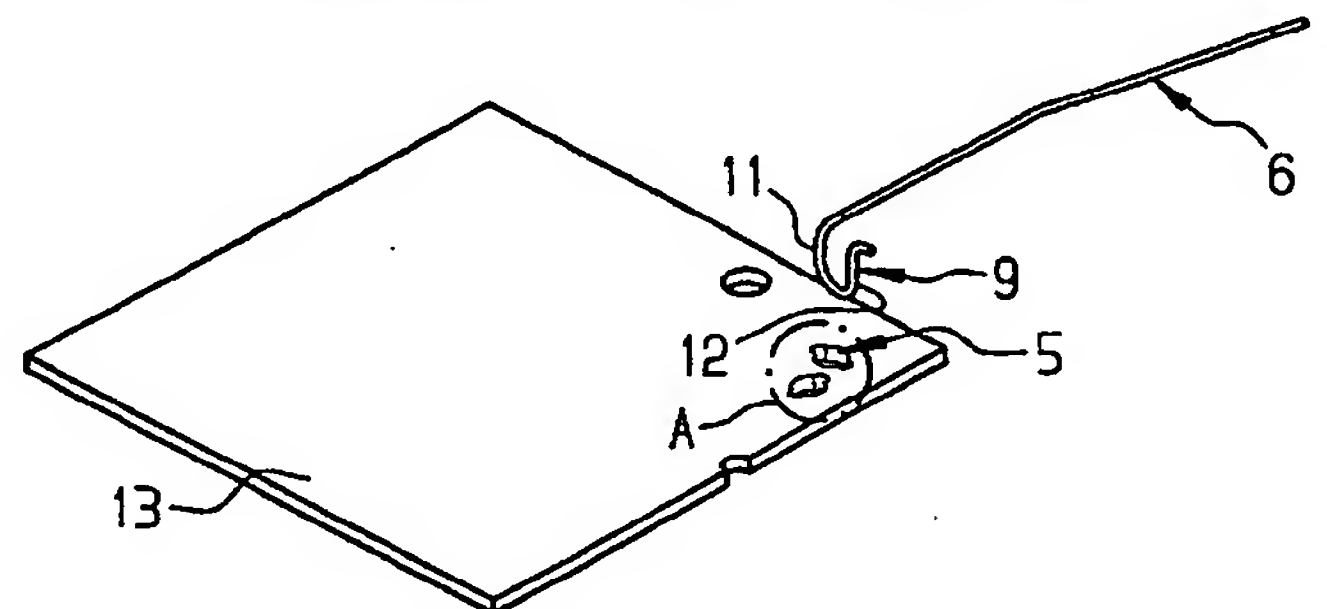
⑦② Erfinder:  
Holdschlag, Werner, Dipl.-Ing., 46414 Rhede, DE;  
Umland, Claude, Dipl.-Ing., 46282 Dorsten, DE

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen**

⑤④ Verfahren zur Herstellung einer Ausnehmung in einer Leiterplatte eines Kommunikationsendgerätes

⑤⑦ Zur Aufnahme des Antennendrahtes (6) innerhalb eines funkbetriebenen Kommunikationsendgerätes dient eine Ausnehmung (5) in einer Leiterplatte (13). Diese Ausnehmung soll kostengünstig hergestellt werden.

Zu diesem Zweck werden in die Leiterplatte (13) zunächst zwei kleinere Löcher (7, 8) gebohrt, wobei die Löcher (7, 8) dem Durchmesser und den Abmessungen des Antennendrahtes (6) angepaßt sind. Mittig zwischen diesen Löchern wird eine weitere Bohrung (10) eingebracht, deren Durchmesser sich bis zum jeweiligen Mittelpunkt der kleinen Löcher (7, 8) erstreckt. Anschließend erfolgt die Durchkontaktierung der so gebildeten Ausnehmung (5).



DE 197 06 281 A 1

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

- Leerseite -